

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SOLOMON
SYSTECH**

SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED

晶門半導體有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2878)

盈利警告

本公告乃由晶門半導體有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱作「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及潛在投資者，根據本集團截至2023年12月31日止年度之未經審核綜合管理賬目初步審閱以及董事會目前可得資料，本集團預期截至2023年12月31日止年度將錄得未經審核股東應佔綜合溢利約18.5百萬美元至19.5百萬美元，較截至2022年12月31日止年度約27.8百萬美元減少約33.5%至29.9%。未經審核股東應佔綜合溢利於2023年減少之主要原因為(i)銷售收入減少，其主要由於本集團產品平均售價下跌；及(ii)毛利及毛利率減少，其主要由於產品平均售價的下跌與本集團部分產品成本的下降不成比例。

儘管2023年之未經審核股東應佔綜合溢利有所減少，惟董事會謹此強調，本集團於2023年之IC總付運仍較2022年穩定增長，顯示本集團有能力在不利的市況下維持穩定的市場份額。本集團的產品開發策略貼合市場需要，使IC付運得以穩定增長，而我們將繼續實施現行嚴格有效的成本控制措施，以提高營運效率。

本公司仍在擬定本集團截至2023年12月31日止年度之全年業績。本公告所載列之資料僅為基於董事會對本集團截至2023年12月31日止年度之最新及尚未經本公司獨立外聘核數師審閱或審核，亦未經董事會審核委員會審閱之未經審核綜合管理賬目所作之初步評估。本集團截至2023年12月31日止年度之未經審核綜合全年業績可能需作進一步調整，並可能與本公告所載資料有所不同。本集團財務資料之進一步詳情預期將於2024年3月底前公佈之本公司截至2023年12月31日止年度之全年業績公告中公佈。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
晶門半導體有限公司
行政總裁
王華志

2024年1月26日

於本公告刊發日期，董事會由(a)執行董事－王華志先生(行政總裁)；(b)非執行董事－馬玉川先生(主席)、王輝先生及康劍博士；及(c)獨立非執行董事－陳志光先生、陳正豪博士及郭海成博士組成。